

基板製造時レジスト表面保護用テープ

薄膜マスキングテープ



接着・粘着



保護



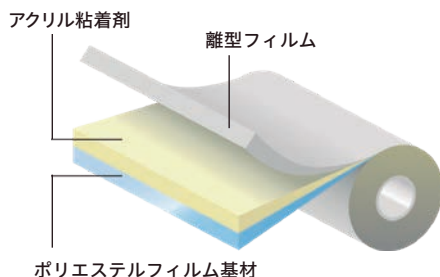
その他



製品HP／お問合せ

特徴

製品構成

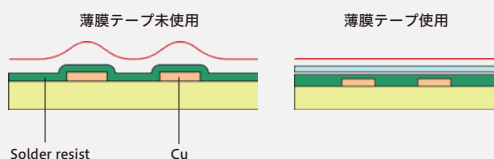


- 1 最適な基板表面形成：
平坦な基板表面形成とアンダーフィル濡れ性向上に貢献
- 2 優れたマスキング：
SRの酸素阻害防止、異物や汚染防止
- 3 軽い剥離力：
残渣なく軽く剥がれる
- 4 シリコンフリー

特性

1. 基板平坦性

ソルダーレジストのうねりをなくし、フラットな基板表面を形成。表面改質によるアンダーフィル濡れ性向上や、多段階積層化に貢献。



■ 基板平坦性検証

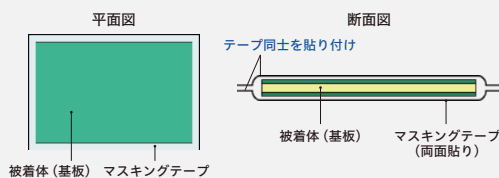
<判定結果>

	薄膜マスキング無し	薄膜マスキング有り
高低差	3.5 ~ 4.1 μm	0.9 ~ 1.3 μm

高低差が少なくなり、表面平坦性が向上しています。

2. 異物除去

薄膜テープを両面に貼り合わせること、SRの酸素阻害防止が可能。
露光前にローラーで異物を除去したり、基板エッジ部からの異物侵入を防ぐことも可能。



3. シリコンフリー

粘着剤表面がシリコンフリー → 基板を汚染しません

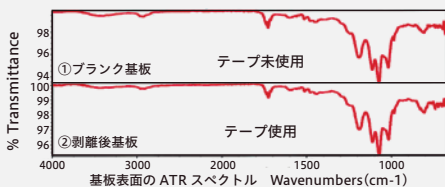
<粘着剤表面のESCA分析結果>

	C	O	N	Si	合計
#3250A	85.46	14.47	0.07	0.00	100.00
PETセパ品	83.61	15.21	0.12	1.06	100.00

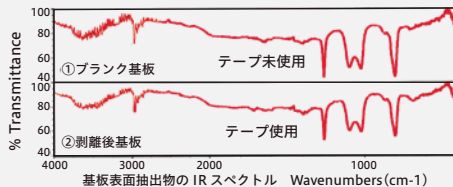
※表中の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

4. 軽い剥離接着力

接着昂進が小さく、露光後も糊残り無く剥離できます。

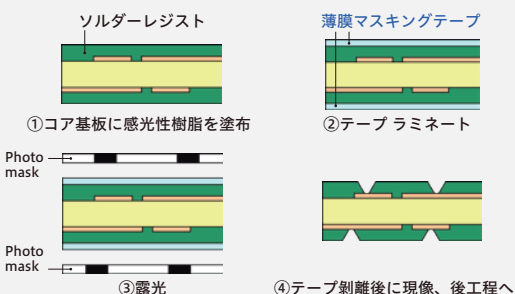


テープ未使用の基板と、テープを貼り付け剥離した基板表面を比較分析してもスペクトルに差は見られません。



テープ未使用の基板と、テープを貼り付け剥離した基板表面から得られた溶剤抽出物の分析を行いました。差は見られません。

想定プロセス



ラインナップ

項目	単位	#3250A	#3204	#3700
厚み	基材	μm	12	12
	粘着層	μm	2	4.5
	離型フィルム	μm	30	30
接着力(対SUS)		N/25mm	0.14	0.26
離型フィルム剥離力		N/25mm	0.09	0.12
トータル光透過率		%	91.9	91.6
ヘイズ		%	4.2	4.0

※表中の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。